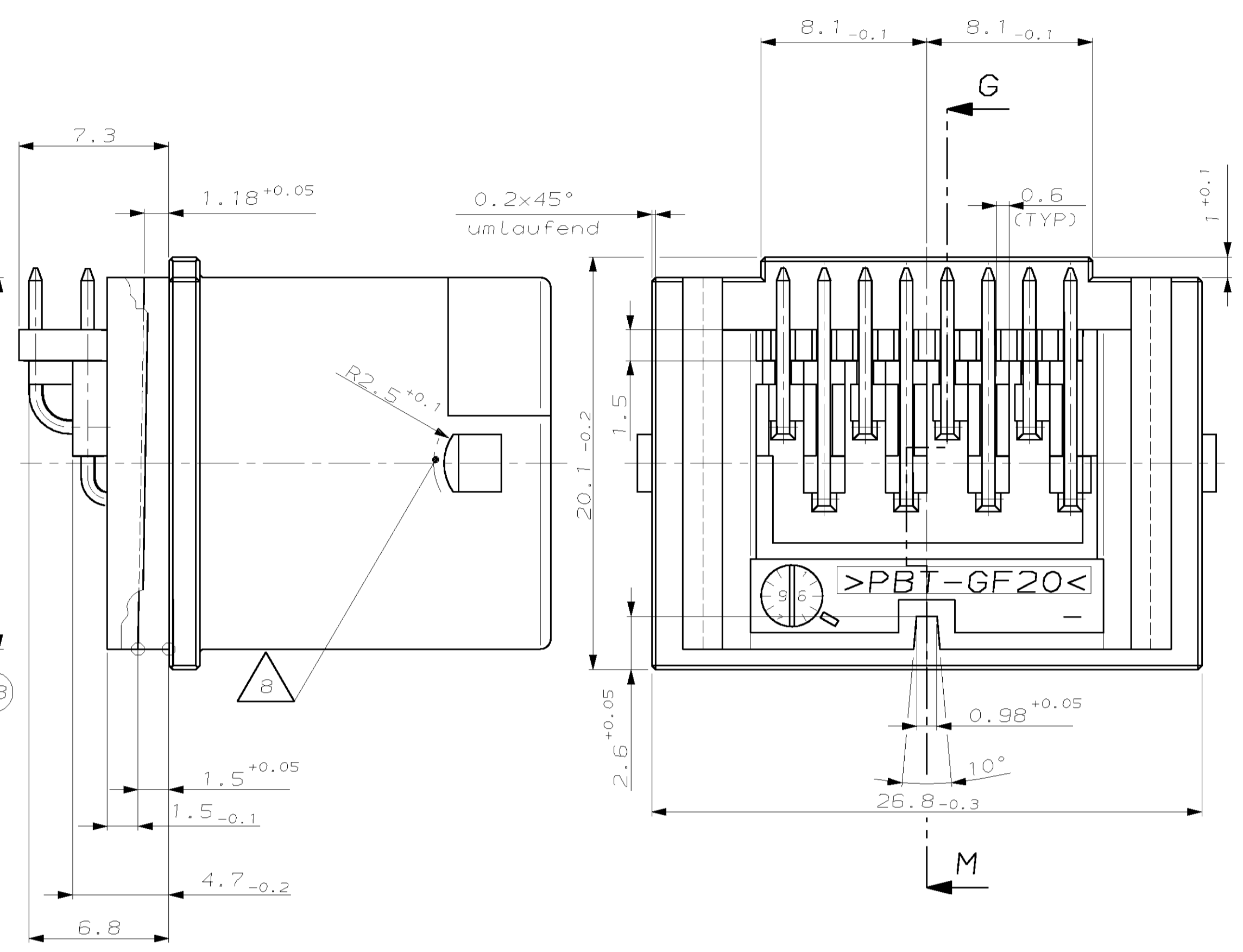
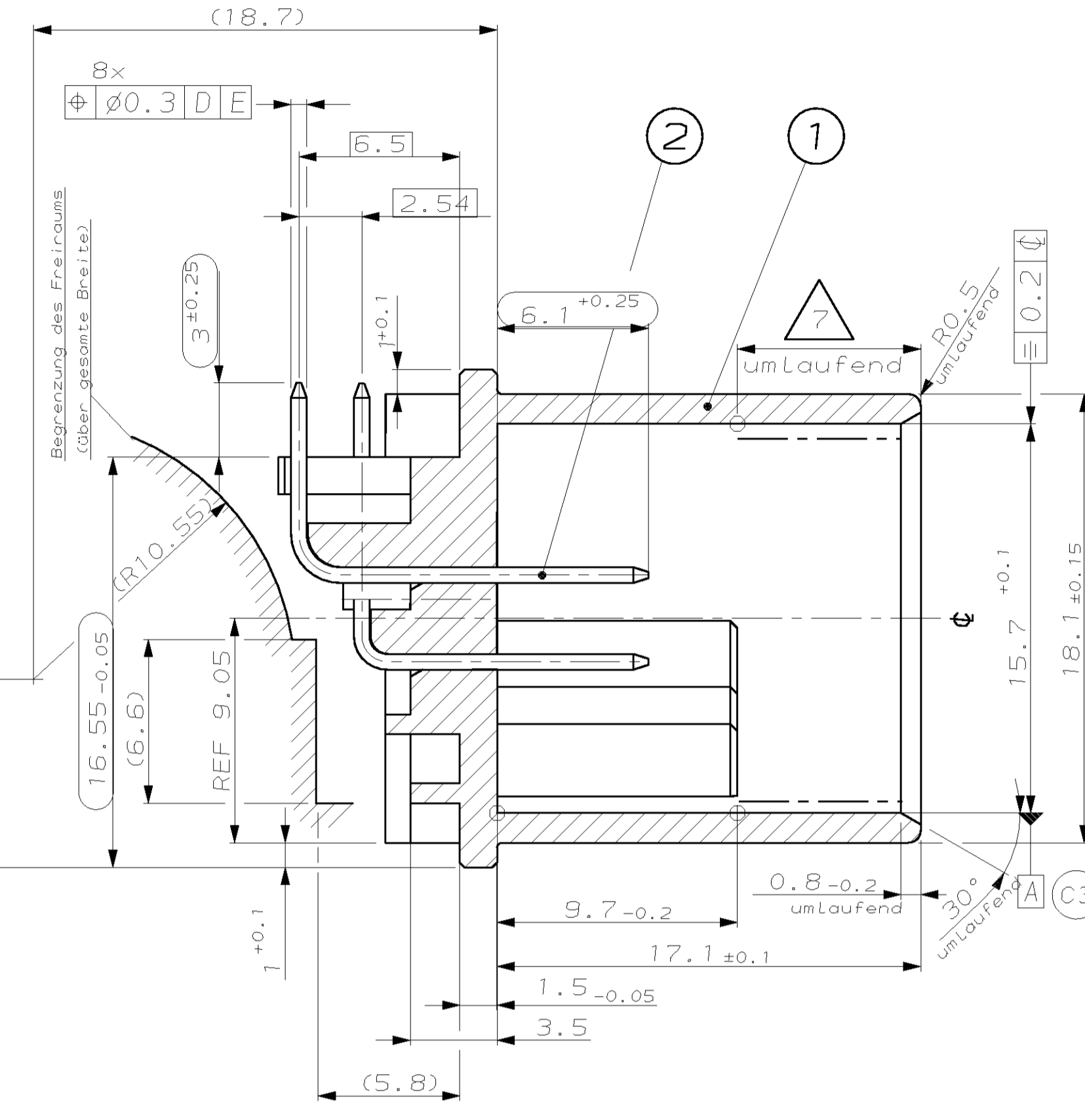
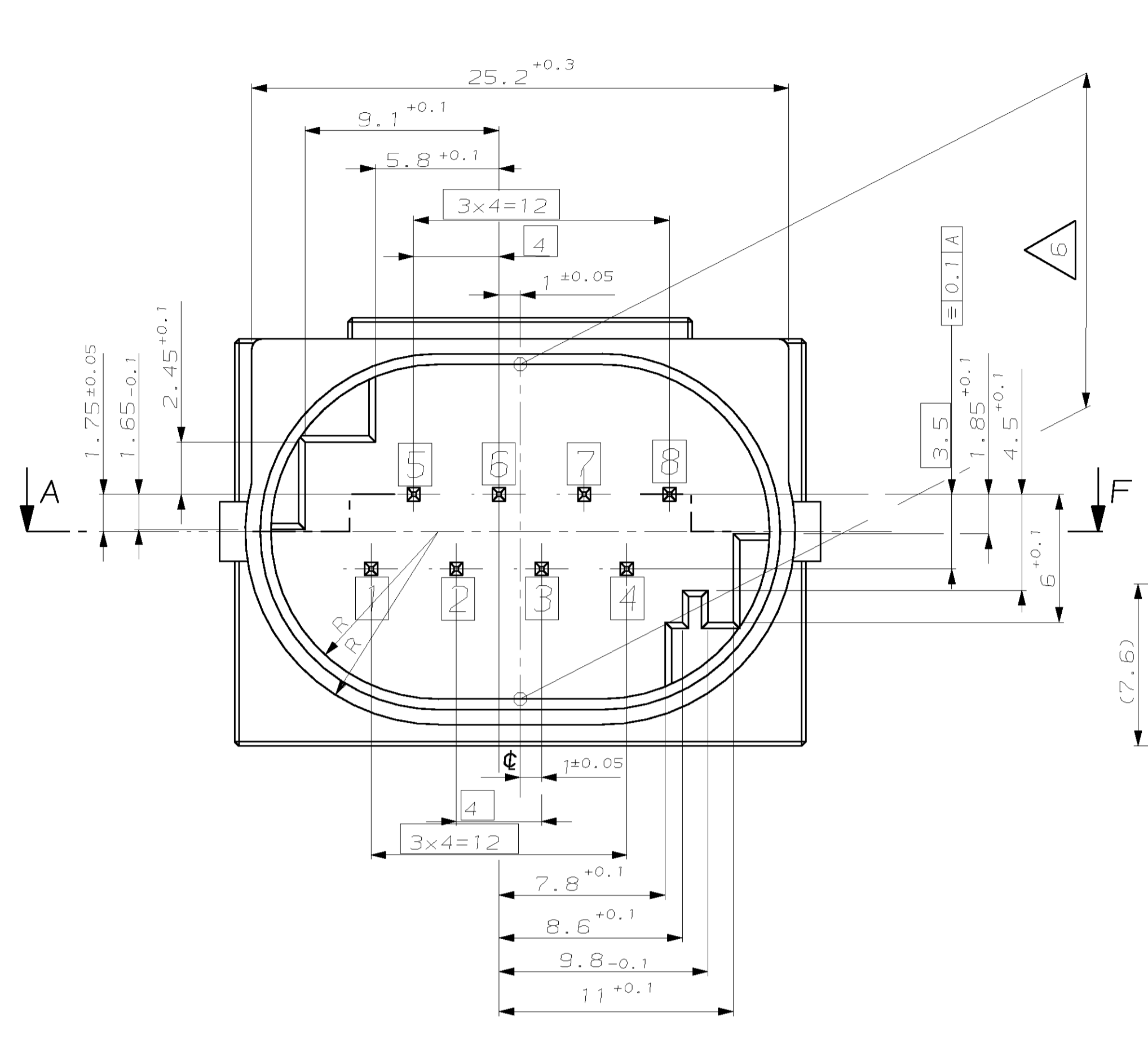


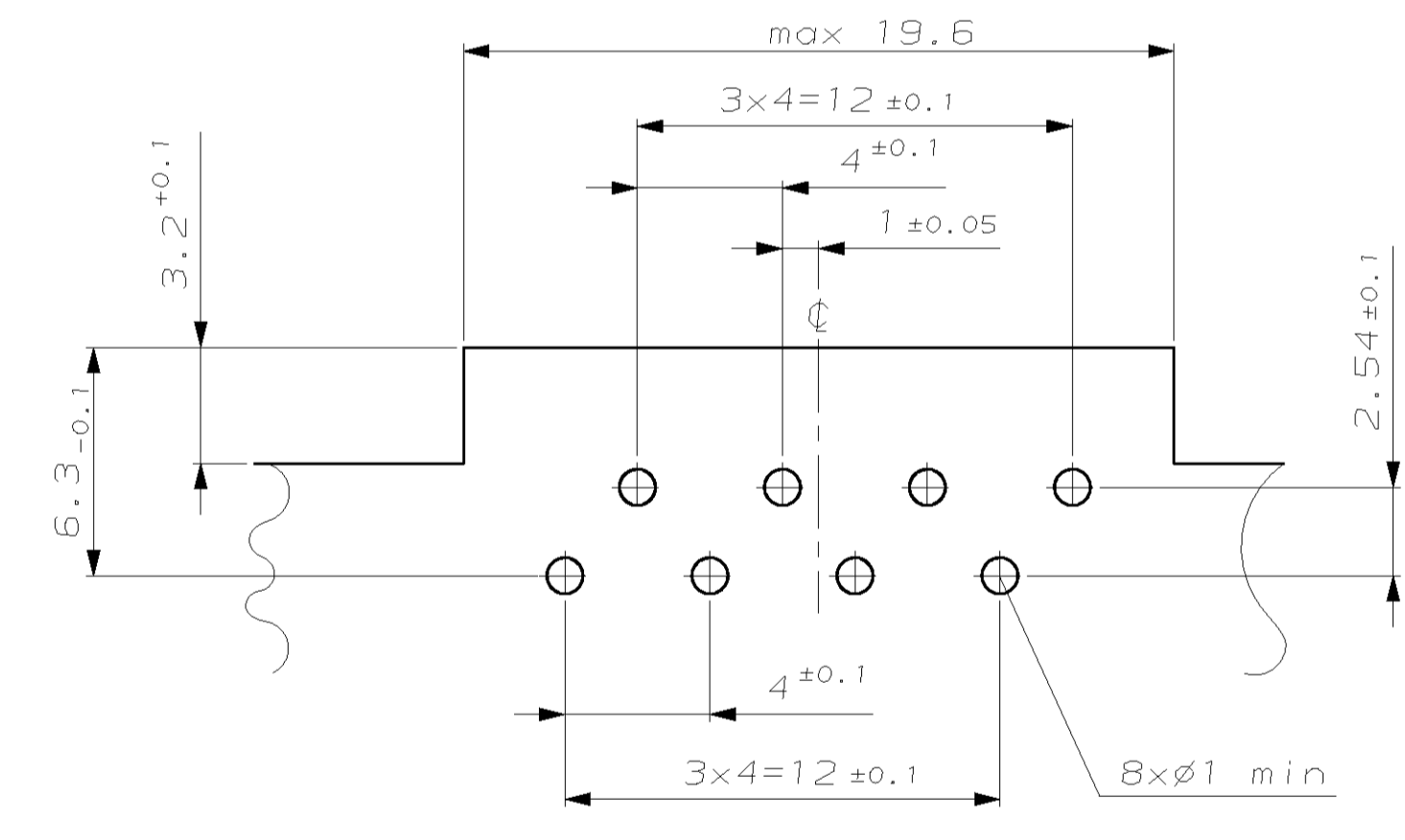
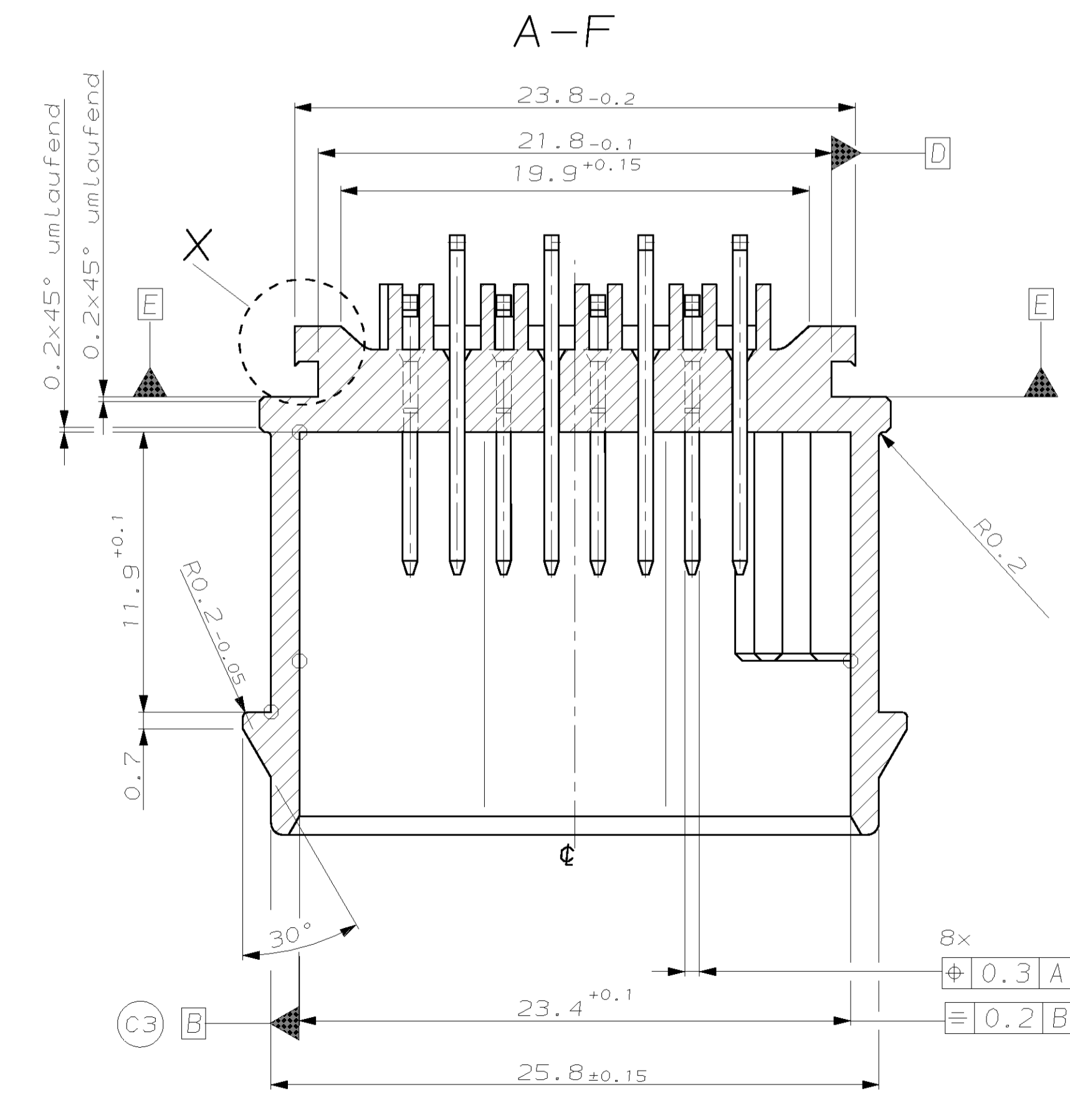
967658  
 VERWENDET FÜR  
 PASSEND ZU  
 95-52078-7  
 CAD-ORIGINAL  
 ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

NICHT VERMASSE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH- NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR	<b>VERTRAULICH</b>		ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1996 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN	REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
		UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Vervielfältigung und Weitergabe ohne GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH		C1	8.1-0.1 (2x), 1-0.1 hinzu, 3 +0.25 was 3 +0.2-0.3	16.07.96	C.Be	
				C2	Leiterplattenlayout und Maß 11+0.1 hinzu	04.06.97	C.Be	
				C3	EGAO 2481 04	08.11.04	C.Be	

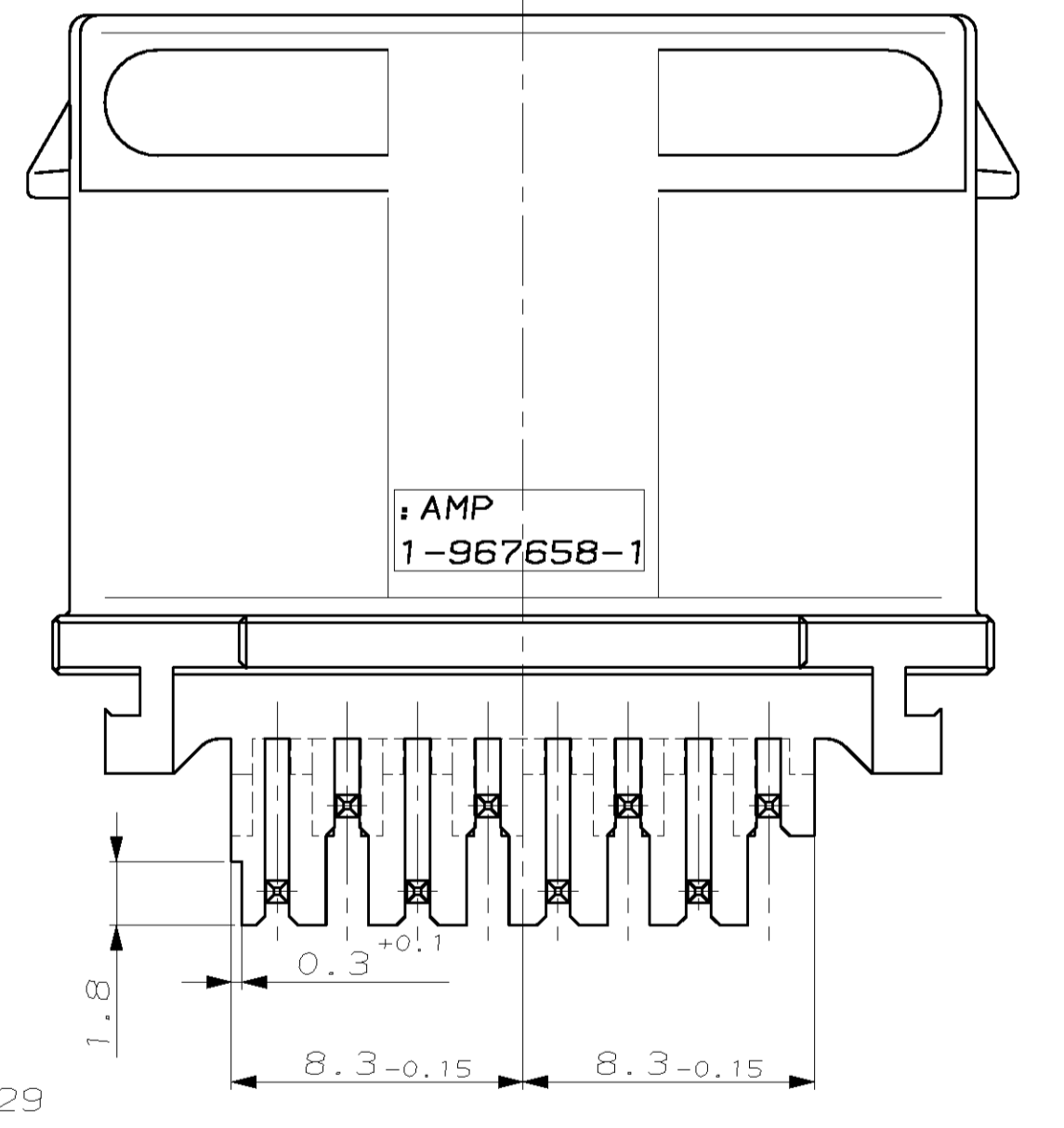
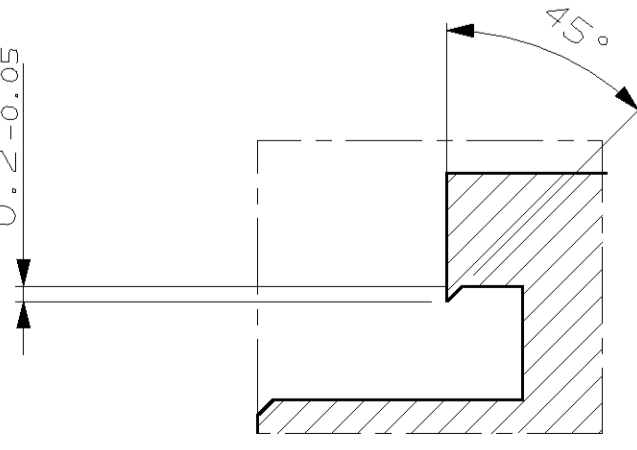
G-M



Leiterplattenlayout  
PCB-LAYOUT



X 10:1



BEMERKUNGEN  
NOTES

1. Verpackung: Schuttgut in PE-Folie und AMP-Karton  
PACKAGING: LOOSE PIECE IN PE-FOIL AND AMP-BOX
2. Kontaktausdrückkraft ≥ 25N  
PRESS OUT FORCE ≥ 25N
3. Lötbarkeit gemäß DIN IEC 68 Teil 2-20, Alterung 3  
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN IEC 68 PART 2-20, AGEING 3
4. Passend zu Buchsengehäuse 8-polig siehe Zeichnung::AMP 1534229  
SUITABLE WITH SOCKET HOUSING SEE DWG.....
5. Produktspezifikation: 108-18568  
PRODUCTSPEZIFIKATION: ....
6. Verzug ±0.1 zulässig  
WARPAGE PERMITTED ±0.1
7. In diesem Bereich umlaufende Dichtfläche, Werkzeugoberfläche Ra=0.7µm  
IN THIS AREA SEALING SURFACE, MOLD SURFACE Ra=0.7µm
8. Trennrat max. 0.1 zulässig  
BURR OF TOOL PARTING MAX. 0.1 PERMITTED

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....		
						AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH D-63225 Langen		
						BENENNUNG Micro Quadlok System Stiftwanne, 8-polig		
						NICHT TOLERIERTE MASSE DIN 16901-140 ± 2°		
						FORMAT A1		
						ZEICHNUNGS-NR. 967658		
						MASSTAB 5:1		
						BLATT 1 VON 1		
						REV. C3		

LOC  
AI  
DIS